

## **Ausstellerstimmen Bondexpo 2009**

### **UHU Vertrieb GmbH**

Die Firma UHU ist seit drei Jahren und somit von Anfang an auf der BONDexpo als Aussteller mit dabei. Natürlich müssen die Messekontakte noch im Einzelnen ausgewertet werden, aber unser erster Eindruck besagt, dass sowohl die Quantität als auch die Qualität der Messekontakte als gut bis sehr gut einzustufen ist. Wir schätzen die BONDexpo als Plattform für unsere Angebotspalette. Dieses Jahr präsentierten wir als Produktneuheit ein spezielles PVC-Klebstoffsortiment (Spezialklebstoff). Damit setzten wir ein zusätzliches Highlight für unseren Messeauftritt und schärften bei den Kunden die Aufmerksamkeit für die Breite unseres Industrie-Sortiments. Wir finden es wichtig, dass die BONDexpo noch weiter ausgebaut wird, zumal es national keine vergleichbare Fachmesse gibt. Kleben ist zweifellos eine Verbindungs- bzw. Befestigungstechnik der Zukunft. Sie bietet gegenüber anderen Techniken viele Vorteile, spart Arbeitsgänge, ist flexibel in der Handhabung und in den verschiedensten Bereichen einsetzbar.

*Stefan Hilbrath, Handelsbereichsleiter Industrie- und Handwerkstechnik, UHU Vertrieb GmbH, Bühl*

### **Diener electronic**

Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der diesjährigen BONDexpo – trotz allgegenwärtiger Krisen-Diskussion. Wir hatten quantitativ wie auch qualitativ sehr gute Kontakte. Das Publikum bestand vorwiegend aus Fachleuten und so wie es aktuell betrachtet aussieht, lief diese Messe mindestens genauso gut wie die BONDexpo im letzten Jahr. Wünschen würden wir uns jedoch, dass wir auf der BONDexpo noch mehr internationales Publikum erreichen. Wir bieten ein breites Produktspektrum und stellen allein in Deutschland auf 12 bis 13 Messen pro Jahr aus. Die BONDexpo rangiert dabei für uns unter den wichtigsten fünf deutschen Fachmessen.

*Ing. Daniela Schubert, Prozessentwicklung, Diener electronic GmbH + Co. KG, Nagold*

## **Ausstellerstimmen Bondexpo 2009**

### **REIS GmbH & Co. KG**

Unsere Schwerpunkte hier auf der BONDexpo 2009 sind die Themen Dichten und Kleben mit Hilfe des Einsatzes von Robotern . Nachdem der erste Messetag für uns etwas schleppend angelaufen war und die folgenden Tage dann anzogen, zeigt sich dieses Jahr insbesondere der letzte Messetag als besonders produktiv. Wir haben hier auf der BONDexpo kaum Schaupublikum, sondern erhalten sehr gezielte Anfragen und führen fundierte Fachgespräche.

*Dipl.-Ing. Michael Knaf, Fachbereichsleiter Kleben und Kunststoffautomation,  
REIS GmbH & Co. KG Maschinenfabrik, Obernburg*

### **tewipack Uhl GmbH - klebetechnik**

Unsere Messeteilnahme sahen wir als Experiment in diesen rauen wirtschaftlichen Zeiten, aber bereits am Montag hatten wir einen guten Messestart. Dienstag und Mittwoch waren dann hervorragende Tage. Wir haben das Gefühl, dass sich die Qualität des Publikums gegenüber den Vorjahren nochmals gesteigert hat und was die Quantität anbelangt, waren wir auch sehr zufrieden. Die neuen Themenparks und den Kongress betrachten wir als Zugewinn für die Messe. Die BONDexpo ist eine feste Position in unserem Messe-Etat, denn sie passt für uns punktgenau, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Von hier aus bearbeiten wir den süddeutschen Markt. Insgesamt können wir nur sagen: Weiter so, denn die BONDexpo ist international die einzige Messe für die industrielle Klebetechnologie.

*Alexander Uhl, Geschäftsführer, tewipack Uhl GmbH - klebetechnik, Althengstett*

### **ARCOTEC GmbH**

Bereits ab dem Mittag des ersten Messetages konnten wir einen großen Besucherandrang verzeichnen. Um allen Interessenten eine umfangreiche Beratung zur ermöglichen, mussten wir an den Folgetagen das Personal aufstocken. Sehr großen Zuspruch fand der Vortrag unseres Dr. Werner Eckert. Wir denken, dass das Kleben inzwischen als echte Alternative in vielen Bereichen der Fügetechnologie gesehen werden kann. Die Qualität des Fachpublikums war sehr gut. Viele Besucher haben konkrete Anwendungsfälle, für die wir gemeinsam die optimale Lösung erarbeiten werden.

*Dipl.-Ing. Kai Harnisch, ARCOTEC GmbH, Mönshheim*